

# 株式会社 サヤカ

東京都  
大田区城南島2-3-3

1975年(昭和50年)設立  
TEL 03-3790-8911

<http://www.sayaka.co.jp/>



代表取締役  
猿渡 盛之

## 生産現場のニーズ を先取りした プリント基板分割装置

家電、携帯電話から自動車まで、あらゆる分野で電子化、情報化が広がる中、実装後のプリント基板を安全かつ高精度に切り離すためのプリント基板分割装置が生産現場を支えている。

### 高精度の微細切断が可能な基板分割装置

電子機器の小型化が進み、プリント基板の生産現場では、複数の同一基板をまとめて一つの基板に実装、個々の基板に分割した後、製品に組み込む方式が主流となっている。同社が開発した基板分割装置は、部品を破損することなく安全かつ高精度の微細切断を高いコストパフォーマンスで実現し、世界中の電子部品実装ラインで活躍中。

### 切断技術の飽くなき挑戦

基板を固定するために真空吸着を用いることで、手間とコストのかからない安定した固定が可能になるばかりでなく、精密基板の大敵となる切断時の切りくずを吸引除去でき、クリーンで高精度の基板分割を実現。また、基板の種類に応じた切削工具の選択、冷凍固定技術の導入など、製造現場のニーズに応えるためにユニークな発想で、常に新しい切断技術に挑戦している。

### 現場の課題解決をビジネスチャンスに

実装プリント基板を分割する際に、手や機械で折って切断すると部品に機械的ストレスが加わり不良が多発してしまう。日本で初めて基板分割装置を開発した背景には、そんな現場の課題があった。「もの作りソリューション」をモットーに、生産現場で困っていることを解決するための新たな技術を使った装置の開発に意欲を燃やしている。



基板分割装置



基板等を、「さいのめ状」  
に高精度に切断